

**AT&S**  
**first choice for advanced applications**

**Präsentation Börse Social Privatanleger Roadshow**  
**28. September 2016**

# Inhaltsverzeichnis

**Überblick**

**Markt, Trends und Positionierung**

**Finanzdaten**

# AT&S – ein weltweit führender High-Tech Leiterplatten-Hersteller

AT&S

High-End Verbindungs-  
lösungen  
für  
Mobile Endgeräte, Automotive-  
und Industrieanwendungen,  
Medizintechnik

Wächst  
kontinuierlich  
stärker als der  
Markt

# 1  
Hersteller in Europa

762,9 Mio. €  
Umsatz im GJ 2015/16;  
5,2 % organisches  
Wachstum

9.165  
Mitarbeiter

Eines der  
profitabelsten  
Unternehmen der  
Branche:  
EBITDA-Marge von 22,0 %  
im GJ 2015/16

# 3  
bei High-End Technologien  
weltweit

Kosteneffizienter  
Produktionsfußabdruck mit  
6  
Standorten in Europa und Asien

# High-End Leiterplatten für High-End Anwendungen

**Segment**

**Mobile Devices & Substrates**

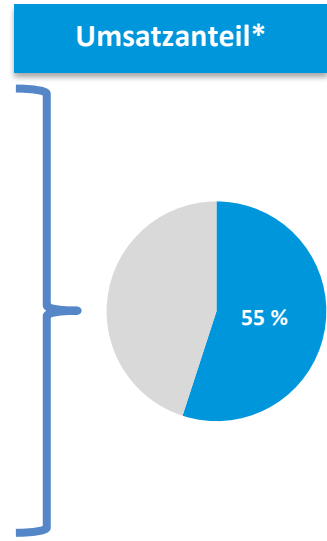
**Ausgewählte Anwendungen**

Tablets, Ultrabooks, 2 in 1

Smartphones

Consumer Electronic

Wearables



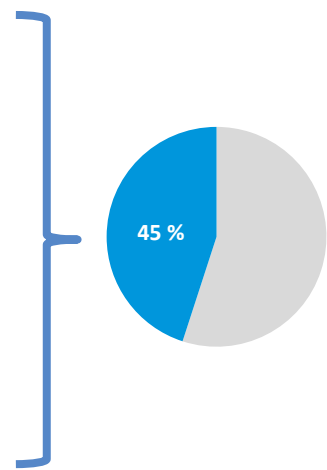
- Ausgewählte Marktführer**
- GoPro
  - Sony
  - LG
  - Canon
  - Qualcomm
  - Blackberry
  - Lenovo
  - Huawei
  - Samsung
  - Xiaomi
  - ZTE
  - Intel
  - Apple

**Automotive, Industrial, Medical**

**Automotive:**  
Navigation, Fahrerassistenzsysteme, Infotainment...

**Industrial:**  
Maschine-zu-Maschine Kommunikation, Industriecomputer...

**Medical:**  
MRT, Hörgeräte, Herzschrittmacher, Patientenüberwachung...



- Continental
- Osram
- Hella
- Siemens
- General Electric
- Harmann
- EADS

\* basierend auf externen Umsätzen



## Vision

First choice for advanced applications

## Ziele

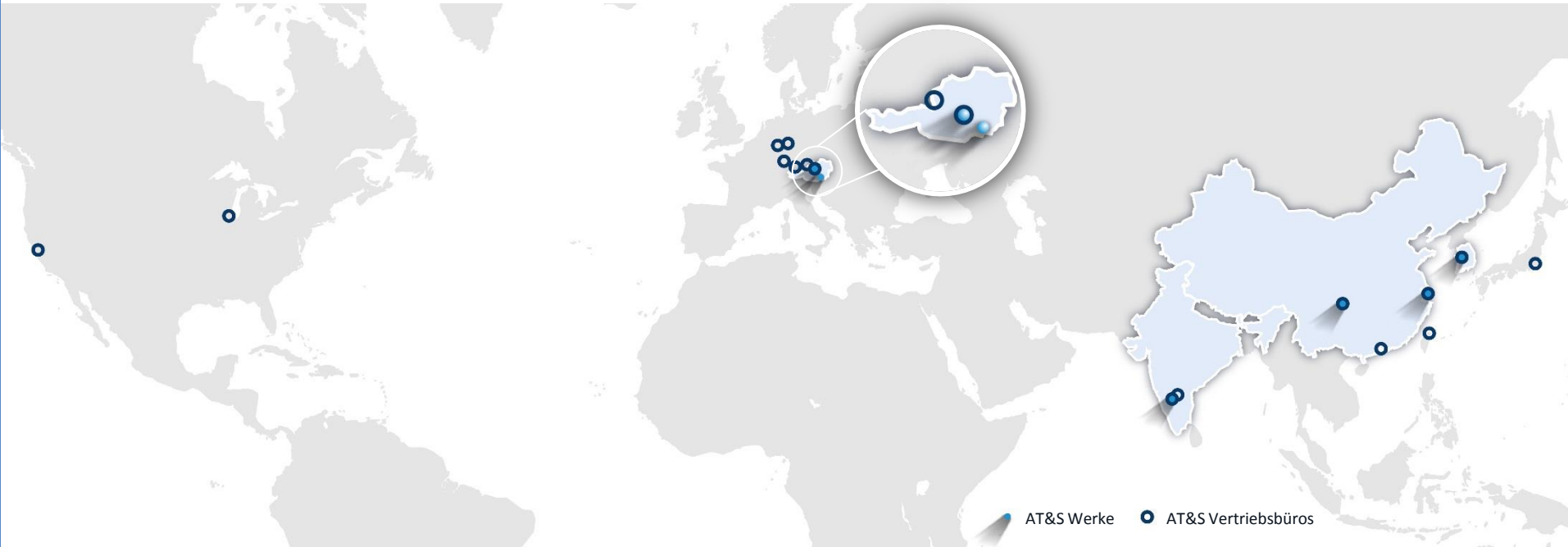
- **Ausbau der Technologieführerschaft**  
*Innovation Revenue Rate von >20 %*
- **Langfristig profitables Wachstum mit dem Ziel, einer der profitabelsten Player der Industrie zu sein**  
*Mittelfristiges Umsatzziel von EUR 1 Mrd. u. EBITDA-Marge von 18-20 %*
- **Schaffung von Shareholder Value**  
*Mittelfristiger ROCE von ~12 %*

## Strategie

- Fokus auf High-End Technologien und Anwendungen mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial und langfristiger Profitabilität
- Höchstes Service-Level und Kundenorientierung
- Operational Excellence
- Fokus auf Cash Flow Generierung

# Globale Präsenz für Kosteneffizienz und Nähe zur Lieferkette

- Produktionsstandorte Europa: hohe Produktvielfalt/niedriges Volumen
- Produktionsstandorte Asien: hohes Volumen/niedrige Produktvielfalt
- Vertriebsnetzwerk umspannt drei Kontinente
- 9.165 Mitarbeiter\*



## Leoben, Österreich Headquarters

Mitarbeiter: 951\*



## Fehring, Österreich

Mitarbeiter: 360\*



## Nanjangud, Indien

Mitarbeiter: 1.108\*



## Chongqing, China in Bau

Mitarbeiter: 1.826\*



## Shanghai, China

Mitarbeiter: 4.556\*



## Ansan, Südkorea

Mitarbeiter: 286\*



\* Durchschnitt, Vollzeitäquivalente, Q1 2016/17; 78 Mitarbeiter an anderen Standorten

# Inhaltsverzeichnis

Überblick

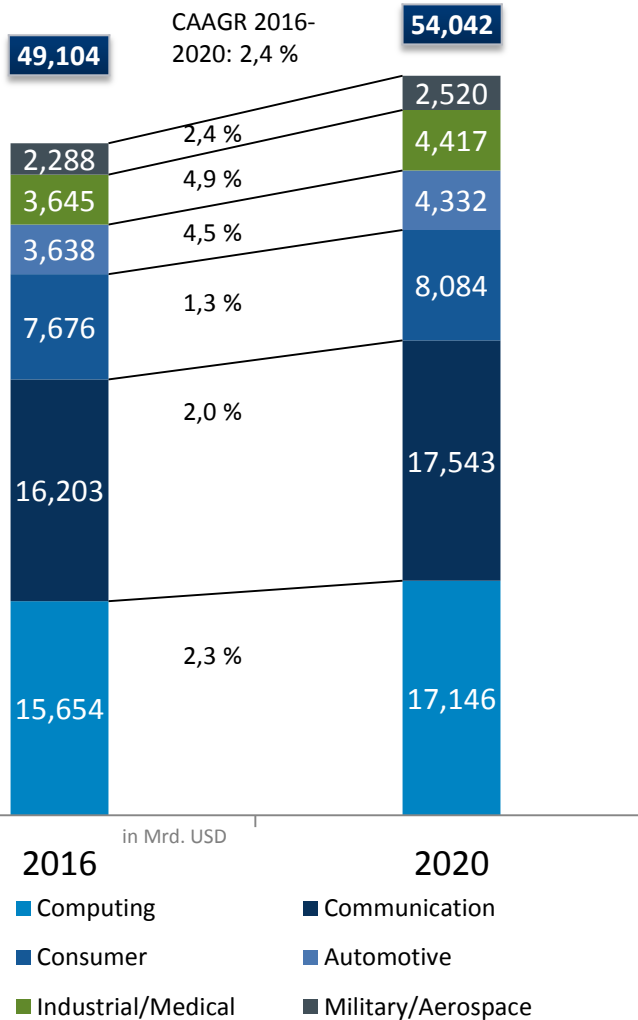
**Markt, Trends und Positionierung**

Finanzdaten



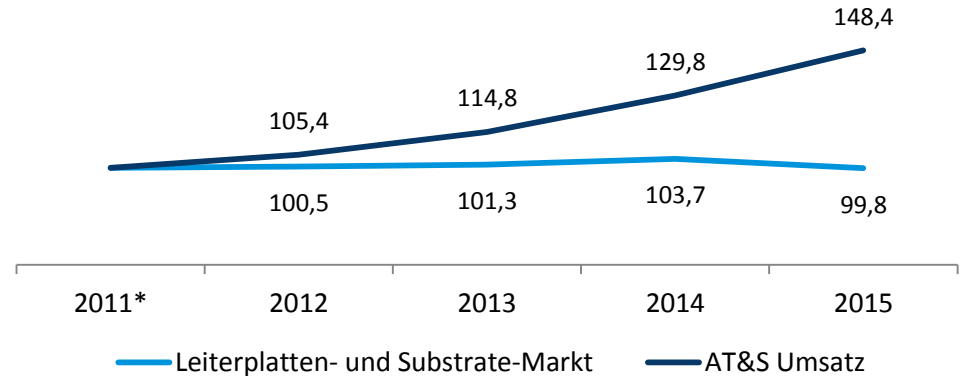
# AT&S ist in den letzten Jahren immer deutlich stärker als der Markt gewachsen

Moderates Wachstum von 2,4 % für den Gesamtmarkt bis 2020 prognostiziert.



AT&S übertraf in den vergangenen fünf Jahren die Marktentwicklung und will auch in Zukunft stärker als der Markt wachsen.

Index (2011 = 100)\*







AT&S konnte das Marktwachstum durch den verstärkten Einsatz von High-End Technologien und den Transfer dieser Technologien in andere Anwendungen/Kundensegmente übertreffen.

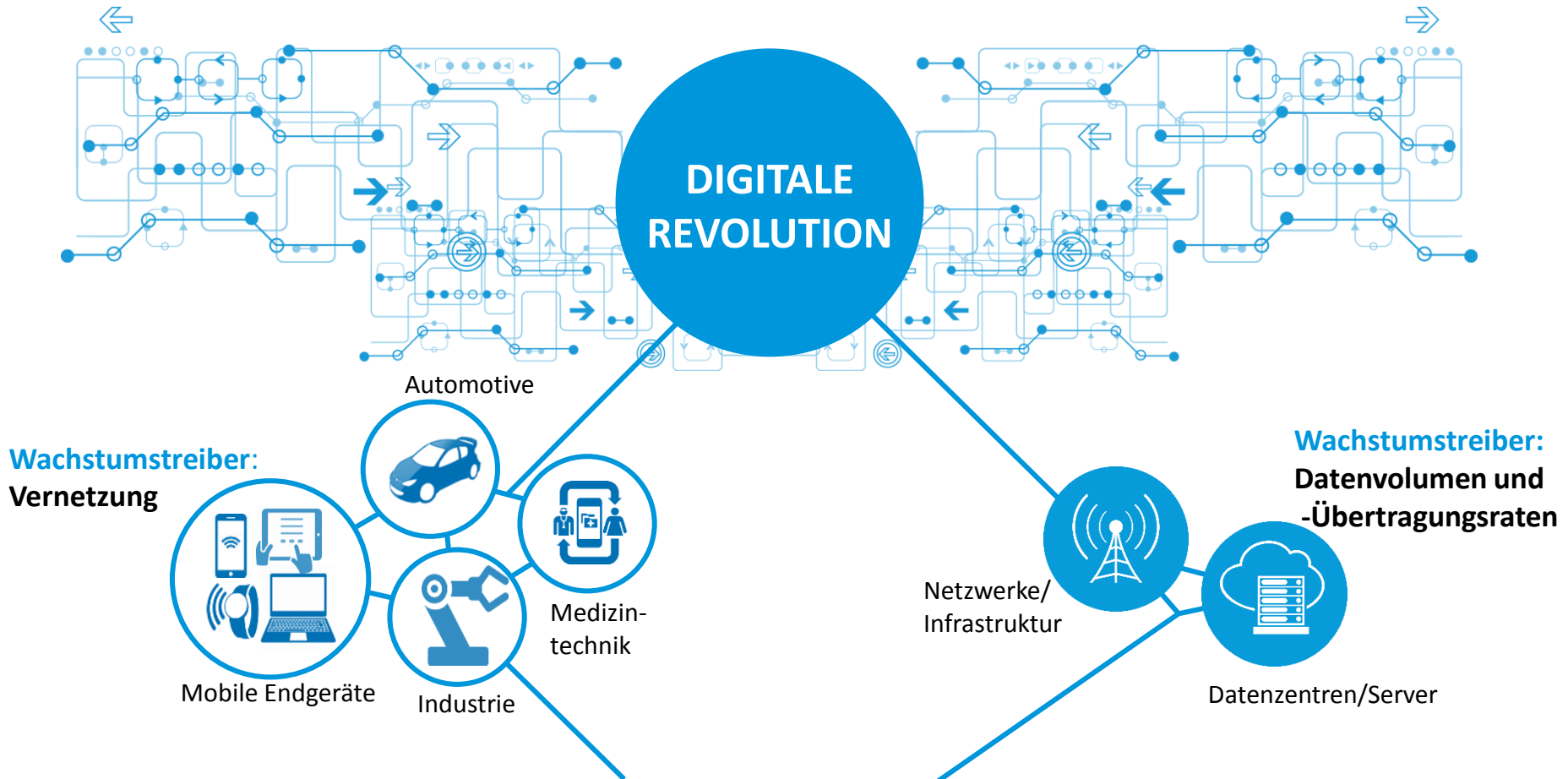
\* Ausgangswert 2011:  
Leiterplatten- und Substrate-Markt: 55,4 Mrd. USD  
AT&S Umsatz: 514 Mio. €

# Mitbewerber im High-End Kerngeschäft

## Marktposition HDI Technologie

Rang	Land	Unternehmen	Umsätze (in Mio. USD)			
			HDI-Technologie	Andere Leiterplatten-technologie	IC-Substrate	Gesamtumsatz
1	TWN 	Unimicron	738	634	758	2.130
2	TWN 	Compeq	624	486	-	1.110
3	AUT 	AT&S	557	329	-	886
4	JPN 	Ibiden	462	376	655	1.493
5	KOR 	SEMCO	392	200	970	1.562
6	USA 	TTM	376	1.046	-	1.422
7	TWN 	Zhen Ding	369	2.114	-	2.483
8	TWN 	Tripod	321	1.070	-	1.391
9	TWN 	Unitech	302	153	-	455
10	CHN 	Kingboard (E&E)	275	688	-	963

Quelle: Prismark, 2015; JMS 2015; NTI 2015; AT&S Strategy



- **Ø Wachstumsraten zwischen 8 – 60 %\***
- **Anforderung an die Verbindungstechnologie: Miniaturisierung und Funktionsintegration**

\* Quelle: Prismark 2016; Wachstum Leiterplatten, IC-Substrate und Embedding bis 2018.

# Wachstumstreiber der Leiterplattenindustrie: Miniaturisierung & Modularisierung

2003/04



2013



2017



202x

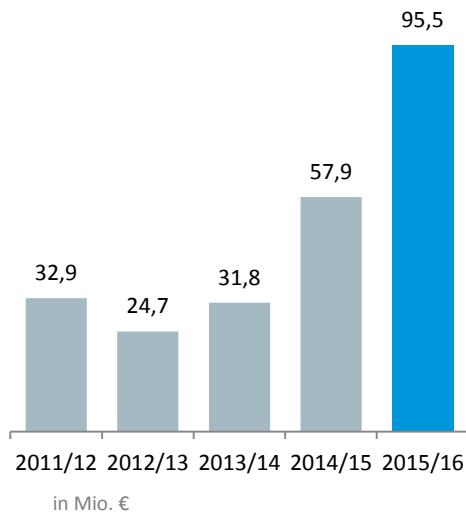


Typ	Mobiltelefon	Smartphone	Smartphone	All in One
Größe				
Leiterplatte	125 x 55 mm	85 x 20 mm	80 x 20 mm	25 x 25 mm?
Abstand				
Leiterzüge	100/100 $\mu\text{m}$	40/40 $\mu\text{m}$	30/30 $\mu\text{m}$	10/10 $\mu\text{m}$

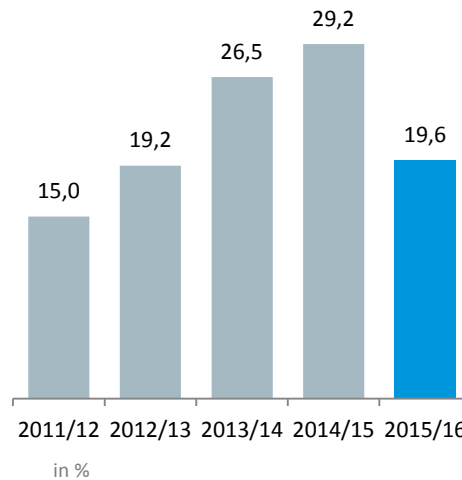
## Innovation als Schlüssel für Technologieführerschaft

- 19,6 % des Gesamtumsatzes im GJ 2015/16 wurden mit neuen, innovativen Produkten erzielt (in den letzten drei Jahren am Markt eingeführt). Rückgang der IRR im GJ 2015/16 aufgrund Abreifung bestimmter Produkte.
- Aktuell: 162 Patentfamilien und 212 Patente.
- F&E Ausgaben von 95,5 Mio. € im GJ 2015/16 entsprechen einer F&E-Quote im Verhältnis zum Umsatz von 12,5 % (8,7 % im Vorjahr), bereinigt um die Entwicklungskosten für IC-Substrate: 4,5 %.

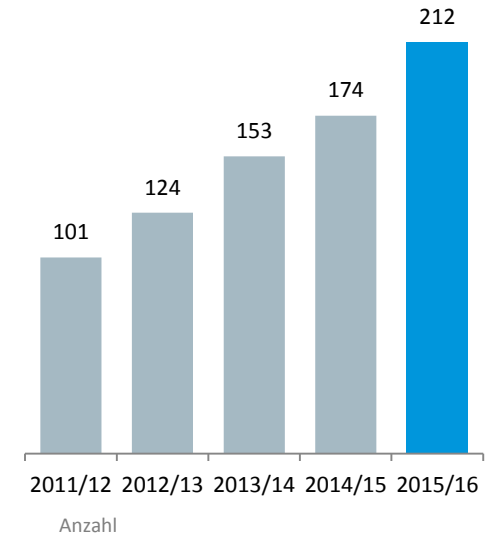
### F&E Ausgaben



### IRR (Innovation Revenue Rate)



### Patente



# AT&S positioniert sich für die Zukunft:

## “Mehr als AT&S”: vom High-End Leiterplatten-Hersteller zum High-End Verbindungslösung-Anbieter

Mehr als

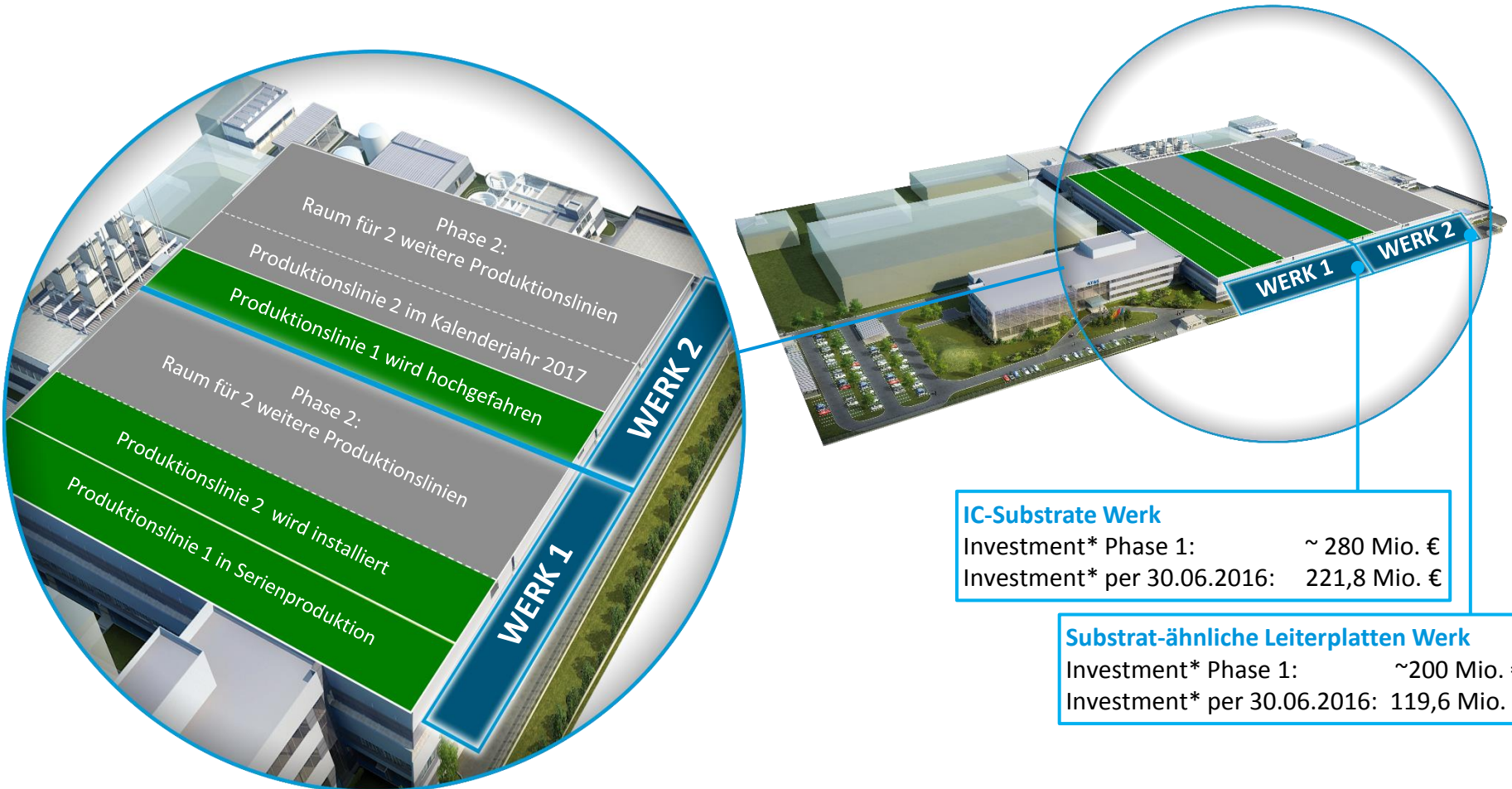
AT&S



# Technologie- und Wachstumsprojekt Chongqing

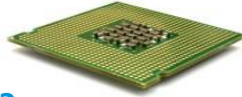
**Gesamtinvestment:** 480 Mio. €\* in der ersten Phase (bis Mitte 2017)

**Ziel:** Ausbau Technologieführerschaft und mittelfristige Unterstützung für hohes EBITDA-Margenniveau



\* Investitionen in Sachanlagen

## IC-Substrate

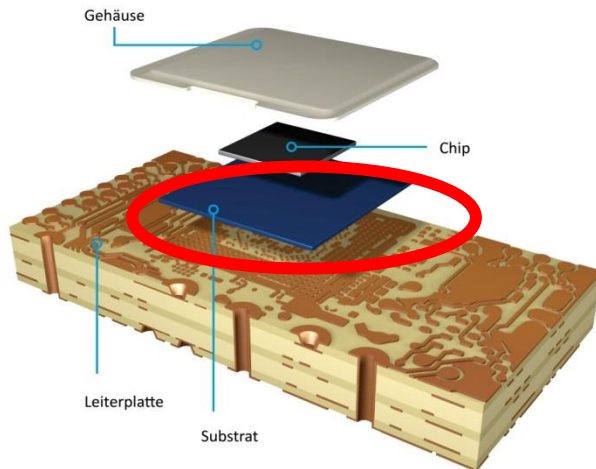


### ▪ Was sind IC-Substrate?

Die Verbindungsplattform zwischen Halbleiter (Chips) und Leiterplatten.

### ▪ Anwendungsgebiete

High-End Mikroprozessoren für Computer, Kommunikation, Automotive und Industrie-Anwendungen.



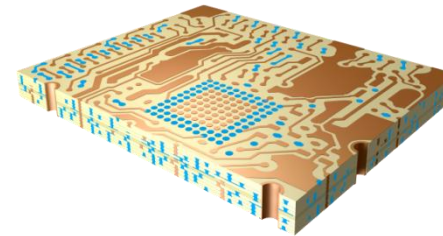
## Substrat-ähnliche Leiterplatten

### ▪ Was sind substratähnliche Leiterplatten?

Die nächste Generation von High-End HDI Leiterplatten

### ▪ Anwendungsgebiete

Voraussetzung für hochentwickelte „Packages“ (Halbleiter und Komponenten bilden ein System) bei mobilen Anwendungen und Wearables.





# Inhaltsverzeichnis

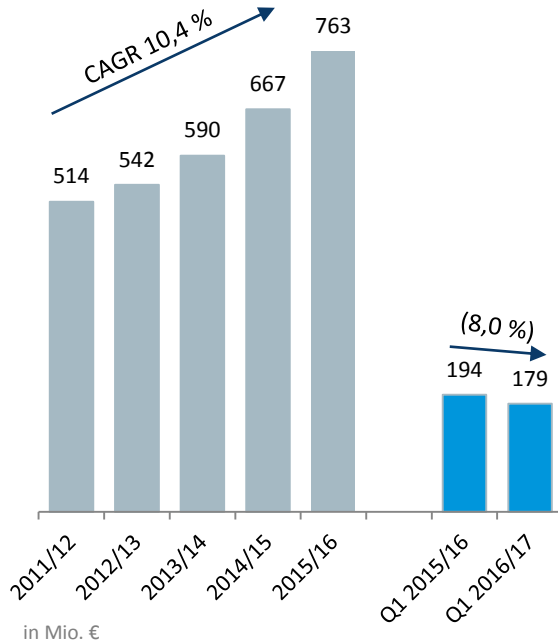
Überblick

Markt, Trends und Positionierung

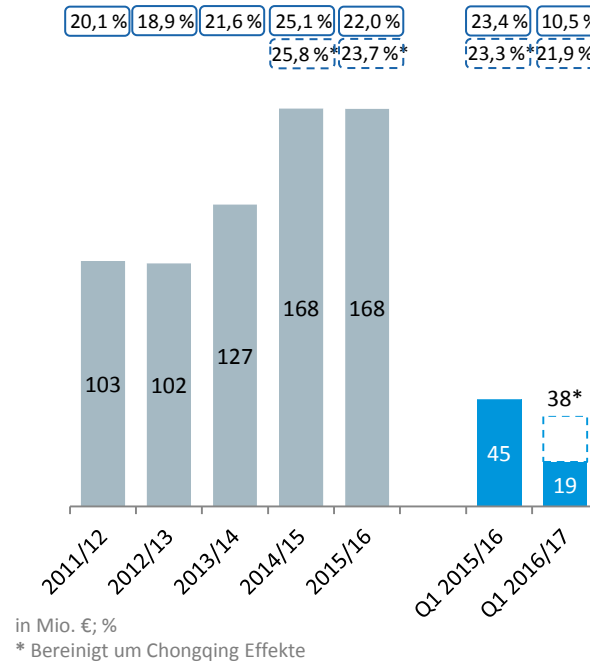
Finanzdaten

# Solides Umsatzwachstum, überdurchschnittliche EBITDA-Margen und starker Cash Flow

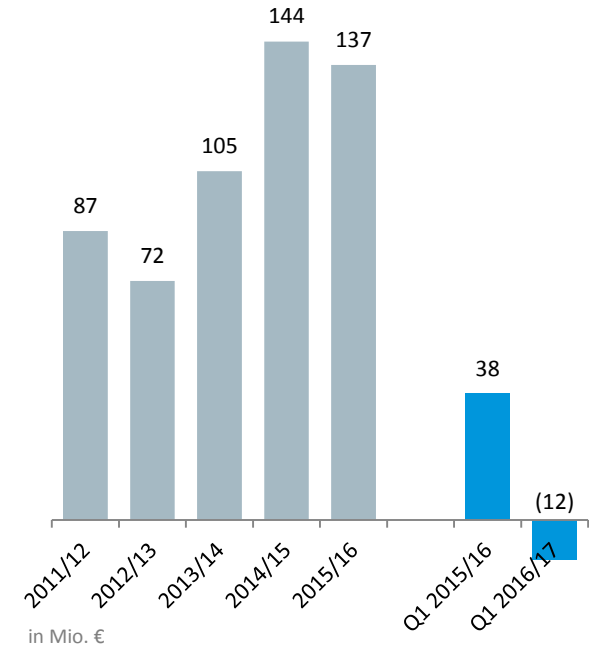
Umsatz



EBITDA und EBITDA-Marge



Operativer Cash Flow



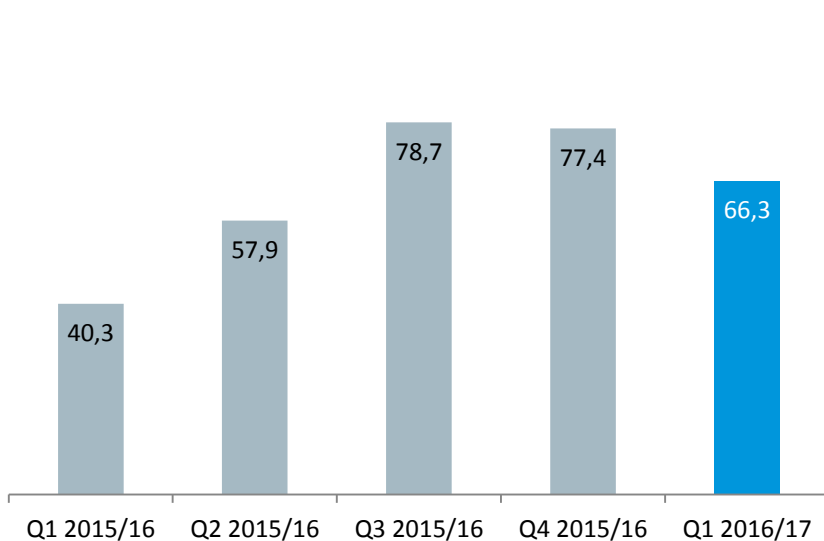
- Umsatzrückgang im Q1 2016/17 aufgrund normaler, erwarteter Saisonalität (Q1 2015/16: keine Saisonalität) und erwartetem Preisdruck.

- EBITDA von negativen Anlaufeffekten der neuen Werke in Chongqing beeinflusst.
- EBITDA-Marge bereinigt um Chongqing Effekte annähernd auf dem hohen Niveau von Q1 2015/16.

- Rückgang aufgrund niedrigerem EBIT und höherer Abschreibungen.

## Netto-Investitionen

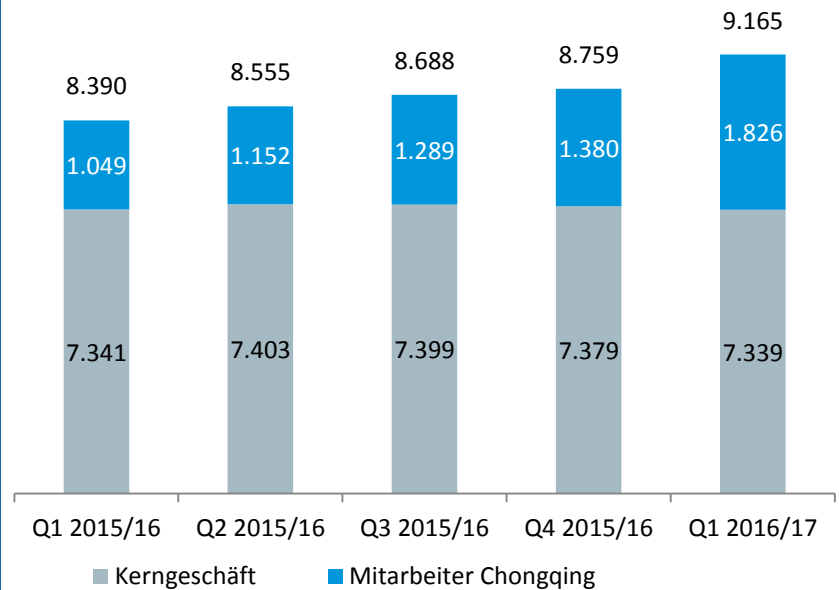
Die Netto-Investitionen beinhalten Investitionen in das Projekt Chongqing (51,8 Mio. €) und Technologieupgrades in bestehende Standorte.



in Mio. €

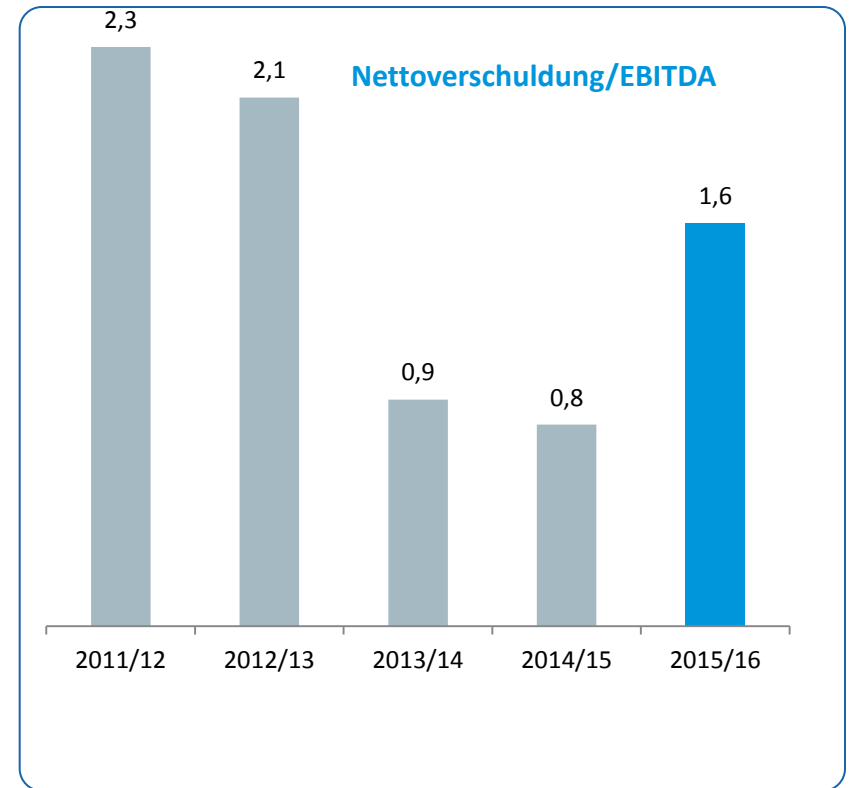
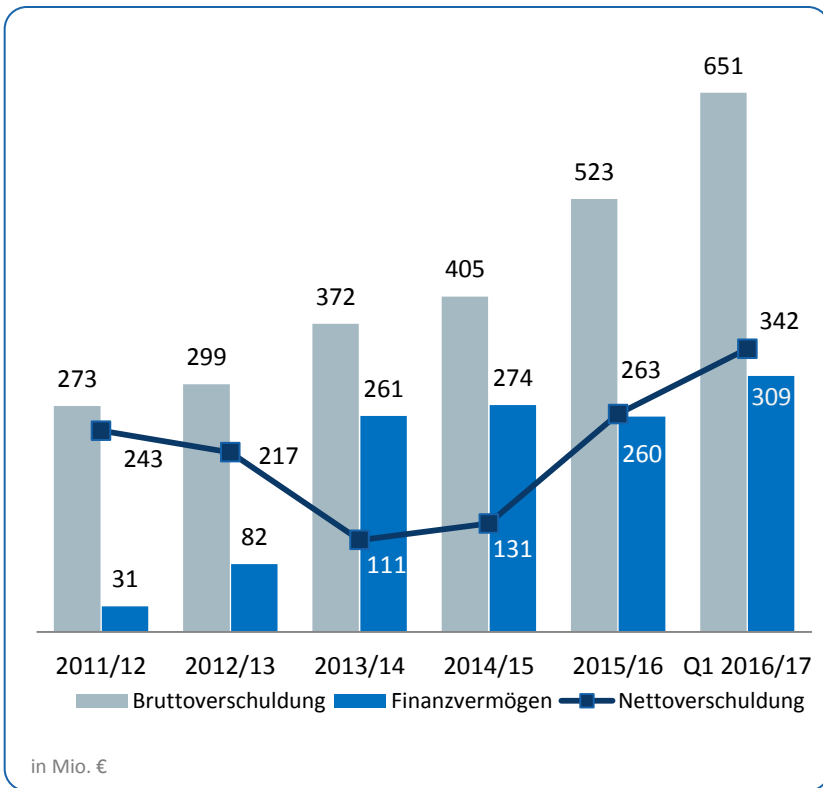
## Mitarbeiter\*

Der Mitarbeiterstand erhöhte sich aufgrund des Projekts Chongqing.



\* inkl. Leiharbeiter, Durchschnitt der Periode, Vollzeitäquivalente

# Bruttoverschuldung, Finanzvermögen und Nettoverschuldung; Nettoverschuldung/EBITDA



- 309 Mio. € Finanzvermögen stellen sicher:
  - Tilgung der Anleihe im November 2016 (EUR 78 Mio.)
  - Finanzierung der Anlaufphase und offener Zahlungen für Investments für die erste Phase in Chongqing.
- Durchschnittliche Finanzierungskosten 2,6 %
- Durchschnittliche Laufzeit: 3,5 Jahre

- AT&S Zielwert: maximal 3,5 x am Höchststand der Chongqing Investitionen.

**Notierung:** Wiener Börse,  
Prime Standard

**Indizes:** ATX Prime, WBI

**Thomson Reuters (A):** ATSV.VI

**Bloomberg (A):** ATS:AV

**Anzahl Aktien:** 38,85 Mio.

**Durchschnittliches Volumen:** 76.900 Stk.\*

**Performance ytd:** -22,84 %\*

**Dividende 2015/16:** 0,36 €/Aktie

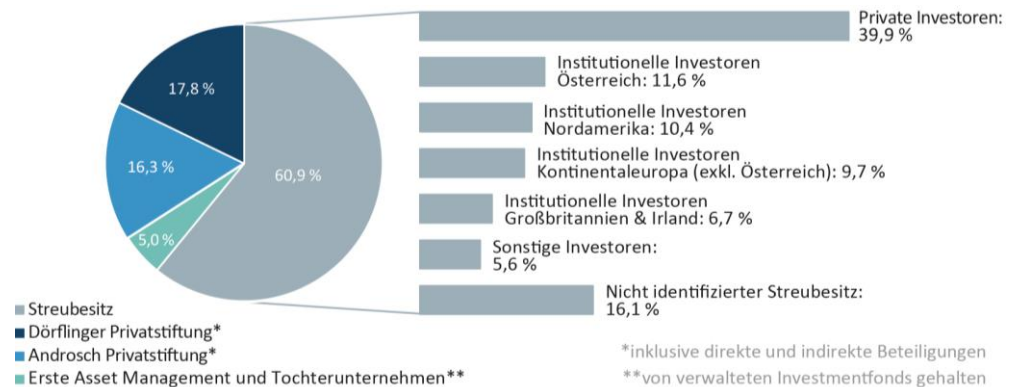
**Dividendenrendite:** 2,8 %

\* 01.01.2016 – 26.9.2016

## Finanzkalender

Ergebnis 1. Halbjahr 2016/17	03. November 2016
Ergebnis 1.-3. Quartal 2016/17	31. Jänner 2017
Jahresergebnis 2016/17	09. Mai 2017
Nachweisstichtag Hauptversammlung	26. Juni 2017
23. Hauptversammlung	06. Juli 2017
Ex-Dividenden-Tag	25. Juli 2017
Nachweisstichtag Dividenden	26. Juli 2017
Dividenden-Zahltag	27. Juli 2017

## Aktionärsstruktur



- Fokus auf Kapazitätsauslastung der ersten Produktionslinie von IC-Substraten und Hochfahren von zwei weiteren Produktionslinien (zweite Produktionslinie IC-Substrate, erste Produktionslinie von substrat-ähnlichen Leiterplatten).
- AT&S erwartet eine Abschwächung der Wachstumsraten in gewissen Marktsegmenten, vor allem im Segment Mobile Devices & Substrates, sowie eine stärkere Saisonalität in Q1 und Q4 und eine weiterhin geringe Visibilität.
- Unter der Voraussetzung eines makroökonomisch stabilen Umfelds, einer Währungsrelation USD-EUR auf ähnlichem Niveau wie im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015/16 und einer stabilen Nachfrage im Kerngeschäft geht das Management für das kommende Geschäftsjahr von einem Umsatzwachstum von 10-12 % aus. Die EBITDA-Marge soll auf Basis der zu erwartenden Belastungen für das weitere Hochfahren in Chongqing bei 18-20 % liegen, die EBITDA-Marge im Kerngeschäft hingegen auf einem vergleichbaren Niveau wie im Geschäftsjahr 2015/16. Die höheren Abschreibungen von zusätzlich rund 40 Mio. € im Geschäftsjahr 2016/17 für das Projekt Chongqing werden das EBIT deutlich beeinflussen.

# AT&S – first choice for advanced applications

AT&S



IR-Kontakt:  
Elke Koch  
Fabriksgasse 13,  
8700 Leoben/Österreich  
Tel: +43 3842 200 5925  
Mobil: +43 676 8955 5925  
Fax: +43 3842 200 15909  
e.koch@ats.net  
www.ats.net

www.ats.net; Twitter: @AT&S IR\_PR; YouTube: Atunds



This presentation is provided by AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft, having its headquarter at Fabriksgasse 13, 8700 Leoben, Austria (“AT&S”), and the contents are proprietary to AT&S and for information only.

AT&S does not provide any representations or warranties with regard to this presentation or for the correctness and completeness of the statements contained therein, and no reliance may be placed for any purpose whatsoever on the information contained in this presentation, which has not been independently verified. You are expressly cautioned not to place undue reliance on this information.

This presentation may contain forward-looking statements which were made on the basis of the information available at the time of preparation and on management’s expectations and assumptions. However, such statements are by their very nature subject to known and unknown risks and uncertainties. As a result, actual developments, results, performance or events may vary significantly from the statements contained explicitly or implicitly herein.

Neither AT&S, nor any affiliated company, or any of their directors, officers, employees, advisors or agents accept any responsibility or liability (for negligence or otherwise) for any loss whatsoever out of the use of or otherwise in connection with this presentation. AT&S undertakes no obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of changed assumptions or expectations, new information or future events.

This presentation does not constitute a recommendation, an offer or invitation, or solicitation of an offer, to subscribe for or purchase any securities, and neither this presentation nor anything contained herein shall form the basis of any contract or commitment whatsoever. This presentation does not constitute any financial analysis or financial research and may not be construed to be or form part of a prospectus. This presentation is not directed at, or intended for distribution to or use by, any person or entity that is a citizen or resident or located in any locality, state, country or other jurisdiction where such distribution, publication, availability or use would be contrary to law or regulation or which would require any registration or licensing within such jurisdiction.